

证券代码： 003031

证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

2025-005 号

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	光大证券 朱宇澍 中国银河证券 李良 信达澳亚基金 陈一博 长江证券 操俊茹 兴业证券 许梓豪 东北证券 黄磊 国信证券 张大为 浙商证券 徐菲 中信证券 郭柯宇 海通通信 夏凡
时间	2025 年 9 月 24 日 （周三）
地点	河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
上市公司接待人员姓名	1. 副总经理 邹勇明 2. 副总经理、财务总监、董事会秘书 董惠 3. 证券部相关工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1、公司上半年净利润增长的主要原因？ 2025 年上半年净利润增长主要原因为公司高端产品放量，叠加降本增效效果明显，公司盈利能力显著提升。 2、公司下半年的经营重点是哪些方面？

	2025 年下半年公司将始终着力于主营业务发展和核心技术创新，不断加强公司的研发能力、提高产品的质量以及提升生产效率，不断积极开拓新市场，扩展新产品，保持公司产品竞争优势，不断推动公司健康发展。 随着 AI 算力需求的持续增长，将推动数字经济蓬勃发展，带动半导体、通信、消费电子、新能源汽车等行业持续增长，以光模块为代表的电子元器件和半导体设备等行业市场规模持续上升。第三代半导体氮化镓通信基站射频芯片与器件领域，紧密围绕战略目标，坚持“市场牵引、科技驱动”，在保持现有优势的基础上，进一步提升市场占有率，保障公司持续、健康、稳定发展。第三代半导体碳化硅功率模块及其应用领域，上半年碳化硅芯片晶圆工艺线经过升级改造由 6 英寸升级为 8 英寸，目前已通线，处于产品升级及客户导入阶段，今后将有效提升国联万众碳化硅功率产品的市场竞争力。 3. 公司光模块陶瓷产品中哪一类产品增长幅度较大？ 光通信市场的繁荣给公司光通讯相关产品领域订单带来增长，公司氮化铝多层薄膜产品实现快速增长，产品应用于高频高速光模块中，应用于 AI 智能和数据中心等新场景。公司时刻关注该类产品更新换代趋势，紧跟市场及技术方向来加快新产品开发，产品结构将随市场需求变化而调整。公司在积极开展现有业务的同时，也在不断探索和跟进行业发展趋势及市场需求。 4. 公司电子陶瓷领域目前产能利用率如何？ 公司产能利用率始终维持在较高水平。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇，加快电子陶瓷外壳生产线项目建设，快速扩产，支撑氮化铝陶瓷基板、消费电子等陶瓷外壳产品实现快速增长。 5. 公司在 3.2T 光模块相关产品是否已有技术储备？ 中瓷公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、1.6Tbps 并均
--	---

	已实现量产。 6. 公司在建项目的进展情况如何？ “氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”根据项目的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要，2024 年 8 月对本次募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”实施地点进行了变更。本次变更有利于募集资金投资项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募集资金投资项目顺利实施，符合经营发展需要，目前该项目处于开工建设阶段，项目主体已封顶。 “第三代半导体工艺及封测平台建设项目”自项目建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施。 以上建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 10 月。公司其他建设项目按照计划进行。 7、公司在 6G、星链通信方面，是否已有相关布局和技术储备？ 子公司博威公司积极推进 5G-A、6G、星链通信等新一代通信系统用射频芯片与器件关键技术突破和研发工作，目前公司在 5G-A、6G 和星链通信相关芯片与器件领域储备关键技术，根据用户需求，稳步推进产品开发和验证工作。 8. 公司精密陶瓷零部件领域今年研发进展情况如何？ 公司已开发了精密陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝核心材料和配套的金属化体系，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台，开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同类产品水平并通过用户验证，实现了关键零部件的国产化，已批量应用于国产半导体关键设备中。2025 年上半年陶瓷零部件新产品研发实现阶段性进展，已通过国产半导体设备上机验证，并实现批量
--	--

	供货。 9. 公司 25 年上半年在碳化硅业务领域有哪些进展？ 2025 年上半年，碳化硅芯片晶圆工艺线经过升级改造由 6 英寸升级为 8 英寸，目前已通线，处于产品升级及客户导入阶段，今后将有效提升国联万众碳化硅功率产品的市场竞争力。
附件清单(如有)	无
日期	2025-9-24